

# 第1回 有機/無機接合研究委員会 プログラム

日時:平成30年6月11日(月) 13:00~16:30

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 912+913 会議室 (東京都中央区)

時間	題目	講演者
13:00~ 13:15	委員会議事	
	司会 井上 雅博(群馬大学)	
13:15~ 14:45	『表面処理技術を用いた、有機・無機材料の 低温接合技術の可能性』 (45分)	早稲田大学 桑江 博之、○水野 潤
	『フレキシブルエレクトロニクスのための 高精度印刷プロセスの開発』 (45分)	産業技術総合研究所 ○牛島 洋史、野村 健一、 日下 靖之、金澤 周介、堀井 美徳、 藤田 真理子、山本 典孝
14:45~ 15:00	休憩	
	司会 松嶋 道也(大阪大学)	
15:00~ 16:30	『粗面化めっき法を活用した異種材料接合』 (45分)	信州大学 新井 進
	『FPCを用いた超薄型高圧電源の開発』 (45分)	新電元工業(株) 指田 和之

( )内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。